

2018-2023年中国PCB行业市场竞争现状分析与未来发展前景预测报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018-2023年中国PCB行业市场竞争现状分析与未来发展前景预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/jichengdianlu/308334308334.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

PCB（Printed Circuit Board），中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的，故被称为“印刷”电路板。

印制板从单层发展到双面、多层和挠性，并且仍旧保持着各自的发展趋势。由于不断地向高精度、高密度和高可靠性方向发展，不断缩小体积、减少成本、提高性能，使得印制板在未来电子设备的发展工程中，仍然保持着强大的生命力。综述国内外对未来印制板生产制造技术发展动向的论述基本是一致的，即向高密度，高精度，细孔径，细导线，细间距，高可靠，多层化，高速传输，轻量，薄型方向发展，在生产上同时向提高生产率，降低成本，减少污染，适应多品种、小批量生产方向发展。印制电路的技术发展水平，一般以印制板上的线宽，孔径，板厚/孔径比值为代表。

PCB之所以能得到越来越广泛地应用，因为它有很多独特优点，概括如下。可高密度化。数十年来，印制板高密度能够随着集成电路集成度提高和安装技术进步而发展着。

高可靠性。通过一系列检查、测试和老化试验等可保证PCB长期（使用期，一般为20年）而可靠地工作着。可设计性。对PCB各种性能（电气、物理、化学、机械等）要求，可以通过设计标准化、规范化等来实现印制板设计，时间短、效率高。

可生产性。采用现代化管理，可进行标准化、规模（量）化、自动化等生产、保证产品质量一致性。可测试性。建立了比较完整测试方法、测试标准、各种测试设备与仪器等来检测并鉴定PCB产品合格性和使用寿命。

可组装性。PCB产品既便于各种元件进行标准化组装，又可以进行自动化、规模化批量生产。同时，PCB和各种元件组装部件还可组装形成更大部件、系统，直至整机。

可维护性。由于PCB产品和各种元件组装部件是以标准化设计与规模化生产，因而，这些部件也是标准化。所以，一旦系统发生故障，可以快速、方便、灵活地进行更换，迅速恢复系统工作。当然，还可以举例说得更多些。如使系统小型化、轻量化，信号传输高速化等。

PCB行业产业链结构

资料来源：观研天下数据中心整理

纵观PCB的发展历史，全球PCB产业经历了由“欧美主导”转为“亚洲主导”的发展变化。全球PCB产业最早由欧美主导，随着日本加入主导行列，形成美欧日共同主导的格局；二十一世纪以来，由于劳动力成本相对低廉，亚洲地区成为全球最重要的电子产品制造基地，全球PCB产业重心亦逐渐向亚洲转移，形成了以亚洲（尤其是中国大陆）为中心、其它地区为辅的新格局。

2008年至2016年，美洲、欧洲和日本PCB产值在全球的占比不断下降，分别由2008年的9.30%、6.65%和21.12%降至2016年的5.08%、3.52%和9.69%；与此同时，中国大陆

PCB产值全球占有率则不断攀升，由2008年的31.18%进一步增加至2016年的50.04%；除中国大陆和日本外的亚洲其他地区PCB产值全球占有率亦缓慢上升。全球PCB行业产能（尤其是高多层板、挠性板、封装基板等高技术含量PCB）进一步向中国大陆等亚洲地区集中。

观研天下（Insight&Info Consulting Ltd）发行的报告书《2018-2023年中国PCB行业市场竞争现状分析与未来发展前景预测报告》主要研究PCB行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、工艺技术发展状况、进出口分析、渠道分析、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境、重点企业分析（经营特色、财务分析、竞争力分析）、商业投资风险分析、市场定位及机会分析、以及相关的策略和建议。

公司多年来已为上万家企事业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者提供了专业的行业分析报告。我们的客户涵盖了中石油天然气集团公司、德勤会计师事务所、华特迪士尼公司、华为技术有限公司等上百家世界行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。我们的行业分析报告内容可以应用于多种项目规划制订与专业报告引用，如项目投资计划、地区与企业发展战略、项目融资计划、地区产业规划、商业计划书、招商计划书、招股说明书等等。

第一章 PCB行业相关概况

第一节 PCB行业概念

- 一、PCB的定义
- 二、PCB的作用
- 三、PCB产品分类及比较

第二节 PCB行业发展周期

- 一、PCB行业周期理论
- 二、PCB行业周期分析

第三节 PCB行业产业链分析

- 一、PCB行业产业链总体分析
- 二、PCB行业上游原料供应市场分析
 - 1、铜箔市场
 - 2、木浆纸市场
 - 3、玻纤布市场
- 三、PCB行业下游产品需求市场分析
 - 1、通信领域
 - 2、汽车电子领域
 - 3、航空航天领域
 - 4、医疗领域

第二章 2015-2017年PCB行业背景

第一节 2015-2017年宏观经济背景

- 一、2015-2017年国民生产总值
- 二、2015-2017年工业发展形势
- 三、2015-2017年固定资产投资
- 四、2015-2017年消费价格指数
- 五、2015-2017年居民收入情况
- 六、2015-2017年进出口贸易情况

第二节 2015-2017年 政策环境背景

- 一、2015-2017年PCB行业监管部门
- 二、2015-2017年PCB行业监管体制
- 三、2015-2017年PCB行业主要法律法规及相关产业政策

第三节 2015-2017年社会环境背景

- 一、2015-2017年人口环境
- 二、2015-2017年教育环境
- 三、2015-2017年文化环境
- 四、2015-2017年生态环境

第三章 2015-2017年国外PCB行业发展现状

第一节 2015-2017年国外市场运行综述

- 一、2015-2017年国外PCB行业市场规模分析
- 二、PCB 国内转移趋势不可逆转，行业集中度逐渐上升

第二节 国外主要国家市场分析

- 一、日本的高技术高壁垒之路
- 二、RF PCB 助力韩国 PCB 企业再进阶
- 三、数据看台湾 PCB，积极布局 SLP

第四章 2015-2017年PCB行业市场发展分析

第一节 市场发展现状

- 一、市场发展概况
- 二、PCB行业发展历程
- 三、PCB行业存在的问题及策略分析

1.存在的问题

2.策略分析

第二节 2015-2017年中国PCB 产业链分析.

一、PCB 分类与各自的特点和应用领域

二、弯道超车，材料先行

1、铜箔涨价

2、国内覆铜板企业份额不断提升，高频高速逐渐打破垄断

三、产业联动，PCB 设备企业迎契机

第三节 FPC 国产化率仍然较低，加速发展值得期待

一、FPC 产业链相关介绍

二、苹果新品创新带来 FPC 新机遇..

1、无线充电技术介绍

2、iPhone 首次采用无线充电，“风向标”作用值得期待

3、全面屏全面来袭，COF 技术应运而生

三、下游应用多元化，FPC 拥抱汽车电子 / 可穿戴新蓝海

第五章 2015-2017年所属行业数据监测

第一节 2015-2017年PCB制造所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、PCB行业资产规模分析

第二节 2015-2017年PCB制造所属行业产销与费用分析

一、产成品分析

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

六、销售成本分析

七、销售费用分析

八、管理费用分析

九、财务费用分析

十、其他运营数据分析

第三节 2015-2017年PCB制造所属行业财务指标分析

一、PCB行业盈利能力分析

二、PCB行业偿债能力分析

三、PCB行业营运能力分析

四、PCB行业发展能力分析

第六章 2015-2017年PCB行业竞争格局分析

第一节PCB行业竞争结构分析

一、扩产成本上升，产业向龙头集中

1、自动化设备成本提高

2、工艺复杂，人才培养周期较长

3、环保审查和牌照成本变高

二、国内 PCB 大厂投资不断，各厂商加速布局

第二节PCB行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、企业集中度分析

三、区域集中度分析

第七章 PCB行业内主要企业分析

第一节 东山精密

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第二节 景旺电子

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节 合力泰

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第四节 沪电股份

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第五节 超声电子

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第六节 依顿电子

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第七节 生益科技

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第八节 正业科技

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第九节 大族激光

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第十节 深南电路

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第八章 2015-2017年PCB下游重点行业发展现状分析

第一节 自动驾驶+新能源汽车双轮驱动，Auto PCB 前景广阔

一、ADAS 渗透率逐渐提升，毫米波雷达加速发展

二、新能源汽车加速普及，PCB 行业再添催化剂

第二节 5G 风口引领 PCB 再一波浪潮

一、5G 风生水起，中国主动权话语权显著提升

二、5G 时代，通讯 PCB 板潜力非凡

第三节 超算、AI 运算等高性能计算市场持续扩大

- 一、Amazon 和 Google 布局全球的高速计算网络及未来的人工智能
 - 二、始于比特币热潮，但远不止于挖矿
- ### 第四节 汽车用 PCB，蓝海体量巨大

- 一、新能源化趋势明显，我国走在世界前列
- 二、国家政策引导，车企布局将利好上游采购
- 三、汽车电子成为汽车主要创新点，占整车 ASP 持续走高

第五节 FPC 行业集中度高，创新应用和新终端提供快速成长动能

- 一、FPC 应用以智能机为主，行业集中度极高
- 二、苹果主推 FPC，其他品牌逐渐加大用量
- 三、多项创新驱动 FPC 单机价值量快速提升
- 四、汽车电子、可穿戴接力消费电子，为 FPC 打开广阔成长空间

第九章 PCB行业进出口数据监测分析

第一节2014-2016年进口数据分析

- 一、进口数量分析
- 二、进口金额分析

第二节2014-2016年出口数据分析

- 一、出口数量分析
- 二、出口金额分析

第三节 中国各省市进出口分析

- 一、进口情况分析
- 二、出口情况分析

第四节 进出口国家及地区分析

- 一、进口国家及地区分析
- 二、出口国家及地区分析

第十章 2018-2023年PCB行业发展预测分析

第一节 2018-2023年PCB行业市场预测

- 一、2018-2023年PCB行业市场规模预测
- 二、2018-2023年PCB行业市场规模增速预测

第二节 PCB 产品结构趋于高端，产业链优势厂商议价能力强

- 一、PCB 是“电子系统产品之母”
- 二、PCB 产品结构趋于高端，看好 FPC、HDI 和高层板的成长性
- 三、PCB 产业链梳理：“原材料—基材—PCB”优势厂商议价力强

第二节 铜箔供需翻转开启涨价周期，供给侧紧张短期难以改善

- 一、PCB 新旧动能成长交接，下游需求整体上保持稳中有增
- 二、上游产能被锂电挤压，铜箔市场供需翻转，引爆本轮涨价周期
- 三、价格上涨由铜箔传导至中下游，PCB 全产业链进入涨价大周期
- 四、供给侧紧张短期难以改善，涨价周期大概率还将持续

第四节 涨价加速 PCB 行业整合，期待优势厂商乘势脱颖而出

- 一、涨价周期中看好中上游厂商高议价能力带来高业绩弹性
- 二、下游结构性机会突起，汽车电子等利基市场获利空间广阔
- 三、PCB 行业将加速整合，优势厂商值得持续关注

第十一章 2017-2022年PCB行业投资策略分析

第一节 PCB行业发展战略研究

- 一、战略综合规划
- 二、技术开发战略
- 三、业务组合战略
- 四、区域战略规划
- 五、产业战略规划
- 六、营销品牌战略
- 七、竞争战略规划

第二节 PCB行业风险分析

- 一、政策风险
- 二、市场风险
- 三、管理风险
- 四、原材料供应风险

第三节 PCB 行业启动，迎来上行周期

- 一、PCB 种类繁多，市场规模巨大
- 二、随宏观经济波动，PCB 将进入景气新周期
- 三、产业受上游原材料价格波动和制作工艺影响，客户结构决定话语权
- 四、个性定制化强，得客户者得天下

第十二章 2018-2023年PCB行业投资方向分析

第一节 盈利能力和定制化属性兼具，行业格局较为分散

- 一、PCB 行业的盈利能力处于领先的位置
- 二、此产品种类繁多、差异大，定制化程度高，属于非标准化产品
- 三、全球 PCB 产业中心已经逐渐完成了从欧美向亚洲的转移

第二节 优秀企业成长空间百亿以上，规模效应也逐渐凸显

一、健鼎科技

二、北美硬板大厂 TTM

第三节 产业 PCB 产业第二次东移，中国接过生产制造接力棒

图表详见正文（FSWYC）

特别说明：观研网所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，请放心查阅。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jichengdianlu/308334308334.html>